



SEMI-e深圳国际半导体展
暨2025集成电路产业创新展

2025年9月10-12日

深圳国际会展中心（宝安新馆）

SEMI-e深圳国际半导体展 暨2025集成电路产业创新展 展前预览

同期举办：第26届中国国际光电博览会

双展规模：5000+参展商 | 300,000平方米 | 160,000+专业观众 | 110+同期会议

主办单位：
中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)
集成电路创新联盟

承办单位：
深圳市中新材会展有限公司
爱集微（上海）科技有限公司



即刻扫码登记获取参观证件



目录

[P3 SEMI-e深圳国际半导体展暨2025集成电路产业创新展](#)

[P4 细分代表企业](#)

[P5 双展联动](#)



[P7 芯片及芯片设计](#)

[P10 晶圆制造&先进封装](#)

[P13 功率半导体](#)

[P14 半导体设备](#)

[P17 半导体材料](#)

[P19 化合物半导体](#)

[P20 半导体核心零部件](#)



[P23 同期会议](#)

[P26 组团参观 & 一对一采购对接](#)

[P27 官方小程序 & 人才招聘](#)

[P28 交通指引](#)



***本资料由主办方根据展商提交内容整理，当前版本信息截至8月14日，内容将持续更新中！**



关于展会

由CIOE中国光博会携手集成电路创新联盟主办，深圳市中新材会展有限公司与爱集微承办的SEMI-e深圳国际半导体展暨2025集成电路产业创新展将于2025年9月10-12日在深圳国际会展中心（宝安新馆）开幕。全面覆盖设计、制造、封测、设备、材料、EDA/IP、零部件等全产业链生态，构建完整产业图景。并与第26届中国国际光电博览会（CIOE中国光博会）同期同地举办，形成“光电+半导体”的产业协同效应。

双展规模：300,000平方米 | 5000+参展商 | 160,000+专业观众 | 110+同期会议

IC设计与应用

- 汽车电子芯片
- 智能穿戴芯片
- 工业控制芯片
- 通信芯片
- 安全芯片
- 计算芯片
- 传感芯片
- EDA/IP



IC制造与供应链

- 前道制造
- 封装测试
- 装备
- 材料
- 零部件



化合物半导体

- 化合物半导体材料
- 化合物半导体设备
- 功率器件



集成电路龙头企业云集

紫光展锐、中兴微电子、兆芯、北京君正、苏州国芯、紫光同创、华大九天、芯原微、华虹半导体、佰维存储、武汉新芯、增芯科技、通富微电、比亚迪半导体、瑞能半导体、天科合达、北方华创、中微半导体、盛美上海、华海清科、拓荆科技、芯源微、中科飞测、苏州天准、华卓精科、芯上微装、御微半导体、沪硅产业、江丰电子、安集微、上海新阳、中船特气、南大光电、富创精密、沈阳科仪、新松半导体、京仪装备、牛芯半导体、大族微电子、上银科技、基恩士、日联科技、固高伺创、建华高科、烁科晶体、普兴电子、字环精研、平伟实业、季华实验室、示范性微电子学院产学研融合发展联盟、集成电路材料创新联合体、中国汽车芯片产业创新战略联盟、国家第三代半导体技术创新中心(深圳)、新莱集团……

*仅为部分参展企业，排名不分先后

直击产业热点

展会深度锚定产业脉搏，推动热点技术与产业落地深度融合：

先进封装：AI算力驱动下，Chiplet/CPO/TGV等先进封装技术持续突破瓶颈，跨界技术碰撞催生全新可能；

国产崛起：在成熟制程领域，国产设备已从“可用”迈向“好用”，并在多个关键设备环节实现了重大突破和批量应用，替代率快速提升；

材料革命：SiC/GaN等第三代半导体加速产业化，为AR眼镜、新能源等场景注入强劲动能；

芯片创新：高阶智能驾驶引爆高可靠车规芯片需求，AI浪潮推动GPU/TPU及专用AI加速器的架构革新与能效突破。

核心零部件：聚焦国产化、精密化与智能化，半导体设备零部件作为核心构成，其性能、质量与精度直接决定设备运行的可靠性与稳定性。



细分主题代表企业

为方便您提前规划参观路线，特此整理了主题分类整理了部分代表企业：

◆ 芯片及芯片设计：

紫光展锐、中兴微电子、兆芯、北京君正、苏州国芯、紫光同创、佰维存储、武汉新芯、富瀚微、大普技术、芯汉图、进迭时空、海康存储、匠芯创、芯源半导体、华大九天、芯原微、牛芯半导体、硅芯科技、国微芯…

◆ 晶圆制造、先进封装：

华虹半导体、武汉新芯、通富微电、华进半导体、增芯科技、云天半导体、天芯互联、中科四合、杰群电子、佛智芯、民芯科技、巨芯半导体…

◆ 功率半导体：

比亚迪半导体、瑞能半导体、国家第三代半导体技术创新中心、纳微半导体、誉鸿锦、深华颖、澜芯半导体、芯能半导体、爱仕特科技、微容科技…

◆ 半导体设备：

北方华创、中微半导体、盛美上海、华海清科、拓荆科技、芯源微、京仪装备、中科飞测、苏州天准、华卓精科、芯上微装、御微半导体、微崇半导体、日联科技、恩腾半导体、上银科技、新松半导体、山善、容道社、俐玛精测、建华高科、宇环精研…

◆ 半导体材料：

沪硅产业、江丰电子、安集微、上海新阳、中船特气、南大光电、天承科技、硕成集团、路纳尔新材料、华熔科技、3M、瑞信气体、奔朗、艾米新材、柯林奥半导体、国顺、中宝集团、镁葳、成都炭材…

◆ 化合物半导体：

天科合达、烁科晶体、普兴电子、南砂晶圆、盈锐高科、材孜科技、志橙半导体、科友半导体、宇腾科技、众途复材、固勤材料、芯三代半导体、晶飞半导体…

◆ 半导体零部件：

富创精密、杰为科技、雷赛智能、海特传动、全传科技、派纳维森、中村精机、盛拓半导体、百合特种光学、芯密科技、八匹马超导科技、神州半导体、元创精密、恒运昌、森桓密封、上海巨良阀门、星奇（上海）半导体、新莱集团、固高伺创…

多维度的参观资料

精心筹备系列**专业参观资料**—— 半导体高清产业链图、半导体设备/材料/零部件等细分技术维度的产品合集、提前解锁展会全貌的展前预览手册等。凭借这些参观资料，助您科学规划观展路线，实现高效精准的专业参观体验。**可扫码并添加至“我的小程序”，方便随时查看。**





“光电子+集成电路”双展联动，一证参观双展！

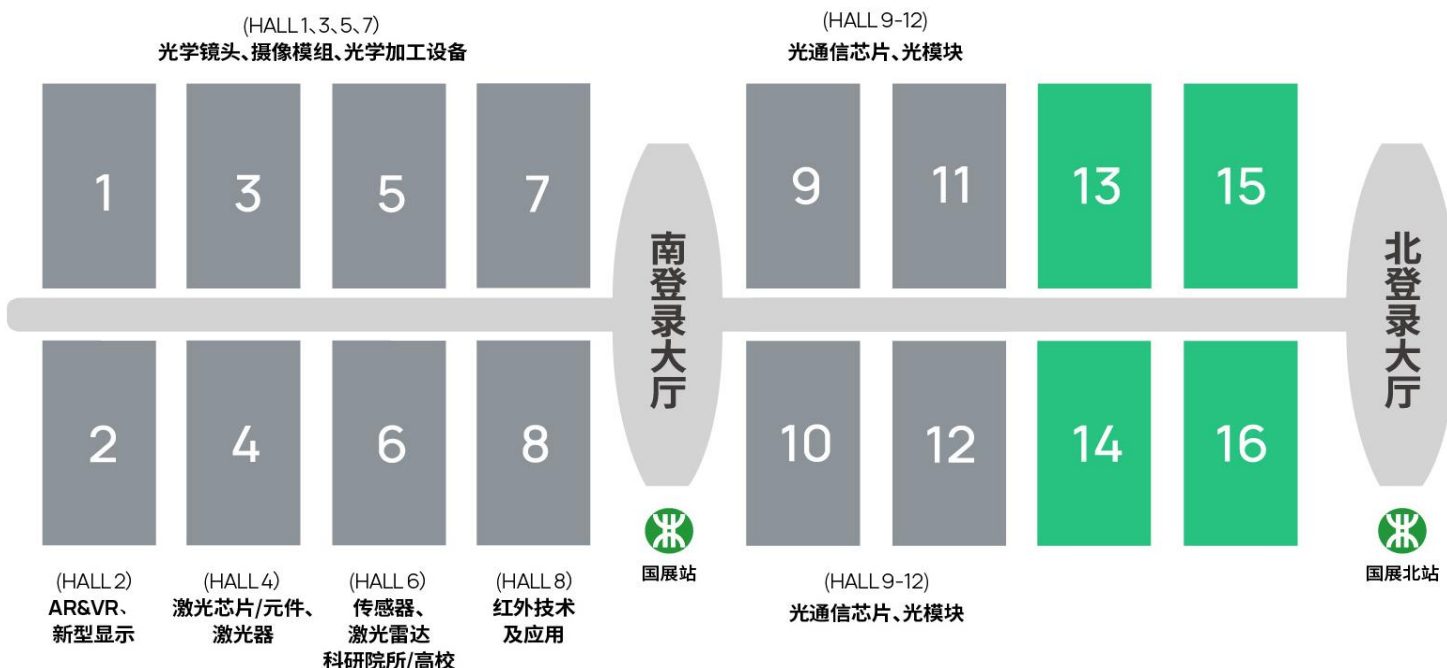
SEMI-e深圳国际半导体展暨2025集成电路产业创新展与CIOE中国光博会同期同地举办，深度融合“光电子+半导体”产业，扩大协同效应，将为企业与应用行业带来更多跨界合作机遇。

CIOE中国光博会集中展示半导体产业链中的传感器及光电子器件，如光电芯片、光器件、光模块、光学镜头及模组、激光雷达、3D视觉等关键核心产品及技术，双展完整呈现集成电路、分立器件、光电子器件、传感器等全品类核心成果，全面覆盖行业前沿技术与创新突破；

部分展示企业涵盖：海思、光迅、华工正源、新易盛、索尔思、昂纳、剑桥、凤凰光学、舜宇光学、联合光电、福光、宇瞳、辰瑞、歌尔、成都光明、联创电子、谷东科技、首镜科技、耐德佳、高德红外、睿创微纳、华感科技、海康微影、索雷博、大立科技、艾迈思欧司朗、灵敏光子、锐芯微、大族、创鑫、长光华芯、华日、公大激光、国创中心、镭昱光电、视涯、维信诺、中科院长春光机所、中科院西安光机所、中科院光电所、中科院上海光机所、中科院上海技物所等；

• 双展联动展馆分布图

展馆分布图



双展联动:



HALL 13-16

SEMI-e深圳国际半导体展暨2025集成电路产业创新展



同期展会 (HALL 1-12)

第26届中国国际光电博览会



特色主题展区

➤ 先进封装展示区 展位号：16F128

先进封装技术作为连接芯片设计与终端应用的关键桥梁，正以“超越摩尔定律”路径重塑产业格局，通过展区的集中展示，能了解异构集成封装技术，感受半导体前沿力量。部分展示企业：安牧泉、盛元半导体、越摩先进半导体、晶通科技、中科智芯、气派科技、芯动微电子、天成先进、新核芯……

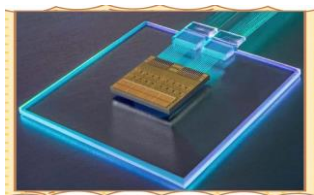


➤ 功率器件展示区 展位号：14F115

汇聚核心功率半导体器件，涵盖 IGBT、MOSFET、SiC/GaN 宽禁带器件及模块。从工业控制到新能源汽车、光伏储能，全场景功率解决方案直观呈现。部分展示企业包括：萃锦半导体、深华颖、纳微半导体、澜芯半导体、南芯微电子、利普思、稳先微电子、森国科、爱仕特科技、芯能半导体……

➤ 芯师爷硬核芯科技园专区 展位号：16G56

从消费电子到汽车电子，从工业控制到人工智能，国产芯片正逐步打破国外垄断，构建自主可控的供应链体系。主办方携手内半导体领域的头部垂直媒体“芯师爷”共同打造特色专题展区——“硬核芯科技园”。为国产芯片企业提供更多展示创新成果与技术实力的平台，助力中国芯走向世界舞台，部分参与企业如海康存储、微容、京微齐力、武汉芯源、宇凡微……



➤ 2.5D/3D先进封装及CPO产业链展示区 展位号：16F132

先进封装技术是Chiplet架构落地的重要支撑，更是2.5D/3D异构堆叠工艺实现性能突破的物理载体，最终通过CPO等技术将芯片级算力高效转化为终端场景适配的连接能力。本展区将串联从设计端、工具链、制造端到设备材料，再到终端落地（AI/光模块/CPO等场景）的全环节。部分展示企业包括：易卜半导体、联合微电子、硅芯科技、奇异摩尔、上海工研院……

➤ 板级扇出型封装创新展示区 展位号：16F12

重点展示板级扇出型封装在超薄高密度互联、异质集成及先进系统封装（SiP）中的创新应用与突破性进展。涵盖从核心工艺开发、材料革新到制造设备优化的全链条创新成果。部分展示企业：佛智芯、肖特集团、巨龙、迈科、华屹……



➤ 新一代工业软件展示区 展位号：14A01

以新一代工业软件工具应用于智能汽车、消费电子、先进制造、机器人四大主题为核心，由深圳市宝安区半导体行业协会牵头，联合软件厂商共同搭建，现场将呈现超过16款工业软件产品，覆盖CAD、CAE、CAM、CAPP/MOM、MBSE板级EDA基础软件、内核、平台等领域的产品，重点展示核心技术创新成果与行业应用案例。部分展示企业包括：新迪数字、千机软件、泊松软件、世冠数智、泊沧数据、迈曦软件、云道工软、深圳景元、十沣科技、开目信息、启云方、芯和软件、中望龙腾、泊川软件、英特仿真、望友工业软件……





芯片及芯片设计

紫光展锐（上海）科技股份有限公司

13F01

紫光展锐 T9100



系统级安全的高性能5G芯片平台

深圳市中兴微电子技术有限公司

13E108

车规级高性能中央计算平台
SoC芯片--撼域M1

撼域 M1 芯片是撼域系列第一颗面向新一代 E/E 架构的车规级高性能中央计算平台 SoC 芯片，具备大算力、高带宽、大存储、高安全的多域融合高速连接能力，可从容应对未来域集中架构的各种应用场景。

上海兆芯集成电路股份有限公司

13B62

兆芯开先KX-7000系列
处理器

采用全新“世纪大道”自主内核微架构和先进的Chiplet互连架构，计算性能提升至2倍。同时IO接口升级至国际主流的DDR5、PCIe 4.0、USB4。集成高性能显卡，图形性能提升至4倍，支持H.265硬件编解码，最高支持双路4K显示。支持构建丰富的桌面整机产品，如台式机、笔记本、一体机、云终端等。

北京君正集成电路股份有限公司

13G01

X2600



X2600 是一款面向商业和工业应用的多核异构跨界微处理器。它以 XBurst2 (MIPS)、Victory0 (RISC-V) 和 XBurst0 的组合作为计算核心。除了常见于应用处理器中的强大计算能力外，X2600 同时还兼具低功耗的实时控制能力。

苏州国芯科技股份有限公司

13E01

CCP907T芯片



CCP907T云安全芯片是国芯科技自主研发的高性能单核微处理器芯片，基于 C9000 PowerPC内核设计，内核支持4发射、9级流水线、超标量等技术，原生支持SMP系统；片上集成多种外设，如PCI-E、USB、GPIO、SPI、UART等，具有商用密码产品认证安全芯片一级资质。

深圳市紫光同创电子股份有限公司

13G05

FPGA芯片



Titan-3系列高端型号PG3T500，支持高达 500k 逻辑资源、高速 Serdes、2800Mbps DDR4、硬核PCIe Gen4x8等高性能FPGA特性，可满足通信、图像视频、医疗、测试测量等领域应用需求。

武汉新芯集成电路股份有限公司

13F66

新芯股份SPI NOR Flash芯片



新芯股份SPI NOR Flash芯片，采用浮栅型（Floating Gate）工艺结构，工作电压涵盖1.2~3.3V，支持低功耗宽电压工作，丰富且小巧的封装规格，助力计算机、消费电子、汽车电子、工业控制、物联网等应用市场发展。

上海富瀚微电子股份有限公司

13A05

FH8856V500



FH8856V500 是专为专业型网络摄像机打造的高性能智能 AI 降噪 SoC 芯片。优势：支持 H.264/H.265 双编码标准，最大支持4K高清视频处理 集成 1Tops 智能算力引擎，支持人宠等多种智能检测算法，支持AIISP，提升夜视成像效果，可完美适配 4M/6M/8M 分辨率的智能 IPC 应用方案 扩展性：芯片配备 USB、SDIO、Ethernet



芯片及芯片设计

广东大普通信技术股份有限公司

13D40

实时时钟芯片



大普技术现已推出RTC全系列芯片，包括：车规级高精度、超高精度、低功耗、分离式、快启抗震等系列芯片。内置自研IC，集成DCXO 32.768KHz，实现全温区高精度±2ppm，低功耗0.2μA (Typ.)，具备多种功能：EVIN、Fout、Timer、Alarm等。采用陶瓷封装，潮敏等级MSL1，抗振动2Wg，具备高可靠性、备份振荡电路。

芯汉图（珠海横琴）半导体有限公司

13C10

STS PCIe Fabric Switch X系列



STS PCIe Fabric Switch Gen5和Gen6芯片，最高可支持144/256条通道，总带宽高达4096 GB/s，单个端口带宽最大可达2048 Gb/s，可向下兼容PCIe 4等协议。芯片采用无阻塞式硬核架构，具备灵活的分区能力和上下游端口转换功能，轻松应对海量数据的高速传输需求。同时具有NTB、低延迟、热插拔、实时故障检测等核心功能。

杭州海康存储科技有限公司

16G56

海康存储企业级SATA III
固态硬盘D300系列

D300系列采用企业级主控，搭载高速3D TLC NAND闪存颗粒，其SATA接口支持6Gb/s的传输速度。凭借端到端数据保护、异常情况只读固件自动重加载等多重安全机制，配合细致调教的磨损均衡算法，有效降低性能波动，确保数据资产安全。该系列已完成多个CPU平台、服务器厂商的产品兼容性互认证，为大数据、云计算等应用场景提供强大的数据底座。

广东匠芯创科技有限公司

16G70

工业级人机交互MPU
D21x系列

D21x系列是一款高性能的全高清显示和智能控制SOC，采用国产自主64位高算力RISC-V内核，内置16位DDR控制器并提供丰富的互联外设接口，配备了强大的2D图像加速引擎和H.264解码引擎，在MJPEG及PNG解码加持下，可以满足各类UI交互设计场景和多媒体互动的流畅体验，完美对接QT、LVGL及AWTK等UI图形框架。

进迭时空（杭州）科技有限公司

13A16

RISC-V AI CPU K1

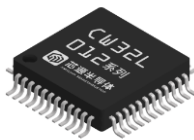


K1 采用同构融合计算技术，集成进迭时空自研的8个高性能计算核X60，可提供50KDMIPS通用算力，同时融合2TOPS AI算力，可流畅运行0.5B、1B的本地大模型。K1 系列芯片主要应用在AI 边缘计算机、AI+硬件、智能机器人、工业主控、云电脑、开源鸿蒙应用等领域。目前量产已超过10万颗，荣获“中国芯”优秀技术创新产品奖。

武汉芯源半导体有限公司

16G56

CW32L012



CW32L012基于ARM® Cortex-M0+内核，主频高达96MHz，同时集成了CORDIC硬件单元、扩展算术运算单元（EAU），可以提供部分数学函数、算术运算的硬件加速，特别适用于电机控制、电源、计量、信号处理等应用。同时，CW32L012是基于 eFlash 的单芯片低功耗微控制器，集成了双12位ADC和双12位DAC，并配备有可灵活连接的双路轨到轨运算放大器，可以在单颗芯片上实现完整的混合信号数字处理。

成都华微电子科技股份有限公司

16E126

HWD08007



HWD08007型SiP芯片是以FPGA+ADC+DAC为核心的系统级模块，将FPGA、ADC、DAC、存储器、接口芯片等关键器件进行系统级集成，配合用户应用软件可实现三轴光纤陀螺信号的处理，具有小型化、低功耗、高可靠的特点。

芯景铄(上海)科技有限公司

16G67

DDR5电竞RGB内存



读取速度至高达8000 MB/s，支持市面上主流的主板RGB灯光控制软件，可自定义自己的专属配色方案，无论单色还是渐变色彩都可满足。即插即用、简易安装、易于配置。



芯片及芯片设计

上海太矽电子科技有限公司

16G76

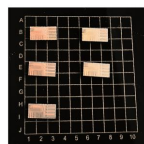
TX2003HV系列 高压大
电流达灵顿晶体管阵列

高压大电流达林顿晶体管阵列，每个阵列包含七个开路集电极共发射极对。每对额定电流为500mA。抑制二极管用于电感负载驱动，输入和输出相对固定，以简化电路板布局。能够驱动各种负载，包括螺线管、继电器、直流电机、LED显示屏、白炽灯、热打印头和大功率缓冲器；有两种外型16针封装（SOP16）。

合肥风致毅半导体有限公司

16G66

硅光芯片



自主研发的VCSEL芯片和硅光芯片，已通过可靠性测试及客户端验证。产品定位0-2km 数通领域，为数据中心提供400G/800G/1.6T光模块所需光芯片及模块方案。集芯片设计、SiP封装、系统应用和市场销售于一体，产品应用领域广泛，涉及通信、算力、数据中心、医疗设备、工业及航天等。

珠海横琴乘翎微电子有限公司

16G72

CLAPM01—单电感双极
输出AMOLED显示电源
芯片

采用全新“世纪大道”自主内核微架构和先进的Chiplet互连架构，计算性能提升至2倍。同时IO接口升级至国际主流的DDR5、PCIe 4.0、USB4。集成高性能显卡，图形性能提升至4倍，支持H.265硬件编解码，最高支持双路4K显示。支持构建丰富的桌面整机产品，如台式机、笔记本、一体机、云终端等。

东莞市达昌智科电子有限公司

16A64

FPGA芯片



中科亿海微品牌高自主高可靠FPGA芯片，采用国产成熟工艺，软硬件一体正向设计，丰富的逻辑资源，实现从“软硬件设计、流片、封装、测试”全流程自主可控。具有高性能、高可靠、低成本、小尺寸、低功耗等特点。

华大九天

13E96

华大九天EDA工具软件系统
及相关服务

主要产品包括全定制设计平台EDA工具系统、数字电路设计、晶圆制造、先进封装设计和3DIC设计等的EDA工具及相关技术服务。其中，全定制设计平台EDA工具系统包括模拟电路设计全流程EDA工具系统、存储电路设计全流程EDA工具系统、射频电路设计全流程EDA工具系统等；技术服务包括基础IP、晶圆制造工程服务及其他相关服务。

深圳国微芯科技有限公司

13D63

芯天成可靠性平台



芯天成可靠性平台集成特征化提取 (EsseChar)、SPICE仿真 (EsseSIM)、单元库验证 (EsseSanity) 及静态时序分析 (EsseTime) 四大功能。借助EsseChar和EsseSIM，用户能快速获取先进工艺节点的特征时序库以及退化时序库，并反馈至EsseTime对大型芯片设计进行时序分析和老化时序分析，实现数字设计一体化。

牛芯半导体（深圳）有限公司

13B61

8400Mbps DDR5
高性能接口IP

牛芯半导体凭借在高速接口领域的技术积累，攻克DDR5/LPDDR5 IP关键技术，其自主研发的“DDR5 MC + PHY IP”完整方案实测速率达8400 Mbps。相较于该IP方案特别适配国产DDR5颗粒并优化调试，在鲁棒性与兼容性上表现卓越，已形成覆盖国内主流工艺节点的“性能+性价比”双优势，助力国产SoC向高端应用升级。

珠海硅芯科技有限公司

16F132

3Sheng Integration
Platform堆叠芯片EDA
平台

3Sheng Integration Platform堆叠芯片EDA平台，创新打造“架构设计--物理设计--Multi-die测试容错--分析仿真--多Chiplet集成验证”五大中心，打通从系统级架构规划到芯片堆叠物理实现的全流程协同优化。提供定制化2.5D Chiplet/3D IC设计解决方案，保障设计精度与性能优势，覆盖多种异质异构混合场景：同构/异构/超异构（含硅光）。



晶圆制造、先进封装

上海华虹（集团）有限公司

13E71、13E72

12英寸晶圆 (28纳米高效能精简型工艺)

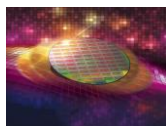


由华虹集团旗下上海华力制造，产品应用于蓝牙芯片、电视时序控制器、WiFi芯片、逻辑图像处理芯片。

上海华虹（集团）有限公司

13E71、13E72

8英寸晶圆 (90nm eFlash)

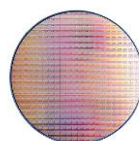


由华虹集团旗下华虹宏力制造，产品应用于物联网、可穿戴设备、工业、汽车电子等领域。

武汉新芯集成电路股份有限公司

13F66

新芯股份三维集成晶圆

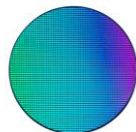


新芯股份拥有国际领先的晶圆级三维集成技术，已构建双晶圆堆叠、多晶圆堆叠、芯片-晶圆异构集成和硅转接板2.5D Interposer等晶圆级三维集成代工平台，可显著降低延时、降低功耗、减小尺寸等，为后摩尔时代全新架构的芯片系统提供创新解决方案。

武汉新芯集成电路股份有限公司

13F66

新芯股份CIS晶圆



55nm CIS工艺，1) 10+年稳定量产经验，全套成熟工艺；2) 像素尺寸 $\geq 0.7\mu\text{m}$ ，分辨率覆盖200~5000万；3) 140dB超高动态范围(HDR)；4) 低照度感光增强；5) 车规级可靠性工艺验证。

通富微电子股份有限公司

13E88

设计仿真和封装测试 一站式服务

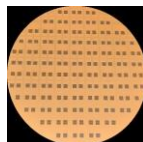


齐全的封装类型，包含了框架类封装(SOT, SOP, QFN, DFN, LQFP, TO, IPM等), 基板类封装(WBBGA, WBLGA, FCBGA, FCCSP, FCLGA等)和圆片类封装(Fan-in WLCSP, Fan-out WLCSP, Cu pillar bump, Solder bump, Gold bump等), 以及COG, COF和SIP等

华进半导体封装先导技术研发中心有限公司

13F118

基于硅桥埋入的扇外型封装集成技术

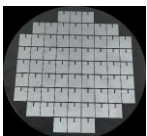


针对人工智能、大数据快速发展的需求，通过硅桥埋入技术，克服了TSV转接板尺寸限制以及Fan out扇出封装RDL工艺微米级金属互连的限制，大幅提升了芯片之间的互联带宽和性能，是一种兼顾成本与高密度集成的新型封装方式。技术能力包括：1) Megal Pillar尺寸/间距：70-100 μm /150-250 μm ；2) 多芯片异构集成能力：支持逻辑芯片、存储器、射频模块等混搭；3) 埋入硅桥颗数：4颗；4) 硅桥线宽/线距及厚度： $\leq 1\mu\text{m}$ L/S和 $\leq 50\mu\text{m}$ ；5) 封装尺寸： $\geq 2\times\text{Reticle}$ 。

华进半导体封装先导技术研发中心有限公司

13F118

基于TSV转接板的2.5D集成技术



面向AI/HPC应用需求，通过TSV硅转接板，完成芯片之间的高密度互连和芯片与基板之间的垂直互连。技术能力包括：1) 可提供TSV 2.5D封装成套解决方案，具有无源/有源TSV转接板研发、工程加工能力；2) 集成芯粒颗数：8颗；3) 封装尺寸： $\geq 2\times\text{Reticle}$ ；4) 解决了晶圆翘曲问题，实现C2W晶圆级组装和C2S基板组装；5) 业内首套2.5D集成Assembly-Level PDK套件。

广州增芯科技有限公司

13D46

BCD工艺晶圆



集成双极型晶体管、CMOS与DMOS器件于同一芯片，兼具智能控制、高跨导、强负载驱动、高集成度、低功耗及高压大电流能力，广泛应用于消费、工业及车规级电源管理与信号链等领域。



晶圆制造、先进封装

厦门云天半导体科技有限公司

13K30

晶圆级无源器件集成



产品优势：射频器件小型化重要解决方案，具备玻璃基和高阻硅两种衬底 应用于滤波器、匹配双工器、巴伦、耦合器、功分器、衰减器等 2D玻璃基IPD具有低成本优势，3D玻璃基IPD具有高Q值(>50@2GHz)电感、高性能的优势。

厦门云天半导体科技有限公司

13K30

玻璃通孔三维集成



产品优势：优良高频电学特性 大尺寸玻璃易于获取 工艺流程简单，不需沉积绝缘层 机械稳定性强且翘曲小 应用广泛:射频组件、光电集成、MEMS

天芯互联科技有限公司

13J35

IC芯片封装服务



依托晶圆级封装(WLP)、系统级封装(SiP)和板级扇出封装(FOPLP)平台，为客户提供先进封装与系统集成解决方案和集成电路测试解决方案，产品广泛应用于高端医疗、汽车电子、消费电子、工控、通信、半导体测试等领域，为客户提供方案评估、设计仿真、封装测试等一站式服务。

杰群电子科技(东莞)有限公司

13G42

DR.MOS 6X5-39L



应用于开关电源/家用电器/工业电源/DC-DC转换器等领域。采用cooper clip设计和Source Down工艺，极大的降低产品内阻和热阻；高集成度：采用三合一封装，占PCB面积是分离MOSFET的1/4，同时功率密度提升到3倍，增加了超电压和超频的潜力，还降低了由多个元件带来的寄生参数；高效节能：装有Dr.MOS的产品有更高的用电效率。

厦门四合微电子有限公司

13J02

ECP模组产品



ECP(Embedded Component Package) 模组产品：采用埋入式技术将芯片、无源器件埋入到基板里，并在基板上方焊接其他芯片、无源器件以完成一定功能的模组。相对于传统封装技术，ECP技术的芯片集成度更高，可应用于穿戴式设备、三次电源模组等产品中。

广东佛智芯微电子有限公司

16F12

玻璃基板



基于反向光刻技术，采用CPU+GPU的混合超算架构以及开放式的软件架构，核心功能采用CUDA技术加速，从根本上领先于市场同类产品采用的技术路线。目前该产品已具备完整的功能链条，包括精确的制程仿真、DRC、SBAR、OPC、LRC、DPT及SMO等，特别是首次在产线上实现了基于反向光刻技术的全芯片掩模优化应用。

北京时代民芯科技有限公司

13B23

高可靠集成电路封装及检测技术服务

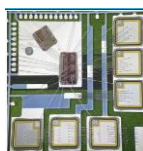


具备国内领先的封装集成设计能力，提供方案规划、电学布线设计、热可靠性仿真等全套服务；具备国际一流的封装加工能力，拥有引线键合封装生产线、倒装焊封装生产线、功率器件与混合模块封装生产线及N1级塑料封装生产线，通过各类别质量体系认证。

东莞市巨芯半导体科技有限公司

13D70

DFN、QFN等工艺的集成电路封装测试服务



专注于集成电路封装测试业务，致力于为客户提供最优质的产品与服务，主要业务包括DFN、QFN等工艺的集成电路封装测试服务。



功率半导体

比亚迪半导体股份有限公司

13C36

超级沟槽栅车规级IGBT芯片——IGBT8.0

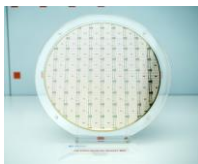


全球领先超大功率密度车规级IGBT芯片，全新一代自主研发IGBT芯片，采用超精细沟槽技术，逼近物理加工极限，能效大幅提升。功率密度全球领先，定义电驱IGBT芯片效能和轻量化设计新标准。

国家第三代半导体技术创新中心（深圳）

14E118

8吋碳化硅平面型MOSFET晶圆



8吋 碳化硅 1.2kV 高可靠平面型 MOSFET晶圆

瑞能半导体科技股份有限公司

14F146

WSJ2M60R065DTL



D F N8080M 氮化镓 场效应管器件 具备高击穿电压、大电流和高工作速度，适用于大功率应用。功能 1栅极驱动电压兼容性（-20V至20V）2高工作频率 3低Qrr 应用 1开关电源 2 交流-直流/直流-直流转换器 3 电机驱动器。

瑞能半导体科技股份有限公司

14F146

TSPAK



采用顶部散热的TSPAK器件实现高效、高功率密度并降低电磁干扰，提升汽车、可再生能源及大功率服务器应用的可靠性。高散热效率TSPAK封装的碳化硅MOSFET和肖特基势垒二极管（SBD），使用新封装技术提升多种高功率的应用效率、减小外形尺寸、延长可靠性并降低电磁干扰（EMI）。

纳微半导体

14F115

GeneSiC碳化硅功率器件



采用了沟槽辅助平面栅极技术，平面和沟槽优势互补，相同电气参数下Rdson随温度变化不到1.4倍，可以承受更大的电流。相同电压等级下，GeneSiC可以为产品提供更低的开关关断损耗和更长的短路耐受时间。

纳微半导体

14F115

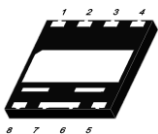
高功率GaN Safe氮化镓功率芯片



纳微半导体的高功率旗舰——第四代GaN Safe产品家族，集成了控制、驱动、感测以及关键的保护功能，使其在高功率应用中具备了前所未有的可靠性和鲁棒性。作为全球氮化镓功率芯片的安全巅峰，GaN Safe具有短路保护（最大延迟350ns）、所有引脚均有2kV HBM ESD保护、消除负栅极驱动并具备可编程的斜率控制。

江西誉鸿锦芯片科技有限公司

14F126

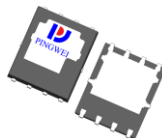
D F N8080M 氮化镓
场效应管器件

D F N8080M 氮化镓 场效应管器件 具备高击穿电压、大电流和高工作速度，适用于大功率应用。功能 1栅极驱动电压兼容性（-20V至20V）2高工作频率 3低Qrr 应用 1开关电源 2 交流-直流/直流-直流转换器 3 电机驱动器。

重庆平伟实业股份有限公司

16F90

PDFN5X6 双面散热功率器件



平伟实业在国内率先推出的 PDFN5X6 双面散热技术产品，并结合 CLIP（夹片）工艺。这种创新封装方式兼顾底部和顶部散热，极大地突破了功率器件的散热瓶颈，将芯片性能发挥到极致。多种封装形式可供客户选择，能灵活满足不同系统空间要求，同时公司还提供定制化服务，从自有封装测试生产线产出，具备高度的自主可控性。



功率半导体

深华颖半导体（深圳）有限公司

14F115

IPM

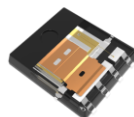


DIP26 SYIM656-DGT 替换 安森美 41560 DIP24 SYIM15G60BTB。

安徽泓冠光电科技有限公司

14G58

MOS系列产品



新一代 MOS 产品采用碳化硅、超结等先进技术，具备低导通电阻、高开关速度、耐高温等特性，可大幅降低功耗与损耗。广泛应用于新能源汽车、光伏逆变、储能系统及高端电源管理等领域，为高效能电力转换提供可靠解决方案。

上海澜芯半导体有限公司

14F115

TSPAK



采用顶部散热的TSPAK器件实现高效、高功率密度并降低电磁干扰，提升汽车、可再生能源及大功率服务器应用的可靠性。高散热效率TSPAK封装的碳化硅MOSFET和肖特基势垒二极管（SBD），使用新封装技术提升多种高功率的应用效率、减小外形尺寸、延长可靠性并降低电磁干扰（EMI）。

宁波萃锦科技发展有限公司

14F115

SiC功率模块62mm



关键指标：Vdss=1200V Id=150-500A Tvjop=150°C 应用：UPS；DC/DC变换器；高频开关；储能系统；太阳能；电动车直流充电。

深圳芯能半导体技术有限公司

14F115

IGBT模块（C4封装）

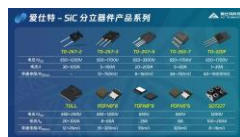


C3/C4系列是一个高集成、相对紧凑的功率模块，用于商业和工业应用。模块拓扑电路中包含整流单元、刹车单元和逆变单元，主要用于37Kw以下功率的工业变频器、伺服控制器、工业风机、工业水泵、商业空调等应用的电机驱动器。C3/C4以1200V电压等级为主。

深圳爱仕特科技有限公司

14F115

碳化硅（SiC）MOSFET & 肖特基二极管



电压范围覆盖650V-3300V，电流范围覆盖5A-200A；主销封装类型包括TO-247-2、TO-247-4、TO-263-7、TOLL、PDFN8*8等。

广东微容电子科技股份有限公司

16G56

高端车规级MLCC



目前微容科技车规级MLCC已实现0201-1210全尺寸全系列的产品开发,成为中国大陆地区首家可以全系列提供满足AEC-Q200车规等级的MLCC制造企业。独立的车规品开发体系、生产设备、生产车间均是微容科技在车规品高可靠性和高一致性上严格的保证。

深圳市芯通电子科技有限公司

14C62

二、三极管，MOS管，LDO,锂电保护IC，充放电IC,电流检测电阻，IGBT,及氮化镓等三代半导体



以功率器件来控制高电压和大电流，高功率电能的半导体器件，主要用工业自动化



半导体设备

中微半导体设备（上海）股份有限公司

13E68

单反应台多腔介质刻蚀机



Primo HD-RIE® 是中微于2015年推出的新一代电介质刻蚀产品是在Primo SSC AD-RIE® 设计基础上实现的具有六个单反应台腔体的系统，为中高深宽比刻蚀提供综合解决方案。具有更高的同步脉冲射频功率、高功率高温静电托盘、气体脉冲、多区气体调节、可冷却聚焦环工艺组件和更稳定的上电极温度控制等。Primo HD-RIE在3D NAND及DRAM中高深宽比沟槽及深孔刻蚀上表现优异，在一些关键制程上已实现量产。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

13E12

面板级先进封装电镀设备



针对半导体制造过程中面板级封装环节的技术难题，提出了创新性的解决方案，可用于RDL的Cu电镀以及bump，Cu/Ni/SnAg的电镀。采用盛美上海自主研发的水平式电镀确保面板具有良好的均匀性和精度，避免了电镀液之间的交叉污染，提升芯片质量的同时提高了效率并降低了成本。可加工尺寸高达600x600mm的面板。

拓荆科技股份有限公司

13D19

VS-300T Astra-s - 12英寸ALD设备



VS-300T 为拓荆自主研发的ALD原子层沉积设备。可搭载4个反应腔，结构紧凑，满足高产能需求，具有优异坪效比及CoO。该系列产品可沉积高质量的SiO₂、SiN_x、TiO₂薄膜，在均匀性、颗粒度、台阶覆盖率等方面达到国际领先水平，满足逻辑、存储等客户先进技术节点要求。ALD薄膜在高深宽比（20:1）情况下台阶覆盖率可达到95%。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司

13D50

半导体专用温控设备



半导体专用温控设备(Chiller)主要用于半导体制程中对反应腔室温度的精准控制，主要由热交换器、循环泵、压缩机和控制系统构成的一个自我平衡的循环装置，属于生产过程中的温控设备。研发人员在常规PID控制算法的基础上加入了预测控制技术和自适应控制技术，显著地提高了Chiller的稳定性、控制精度和响应速度。

深圳中科飞测科技股份有限公司

16F20

三合一图形晶圆缺陷检测设备系列



该系列设备主要应用于晶圆表面亚微米量级的二维、三维图形缺陷检测，能够实现在图形电路上的全类型缺陷检测。拥有多模式明/暗照明系统、多种放大倍率镜头，适应不同检测精度需求，能够实现高速自动对焦。适用于集成电路前道和先进封装领域。

苏州天准科技股份有限公司

13E66

TB系列明场纳米图形晶圆缺陷检测设备



全自动宽波段图形晶圆检测系统，可为8寸/12寸晶圆提供高效、高灵敏度的缺陷检测，应用于前道、后道各工艺层中，满足不同工艺节点缺陷检测需求

上海微崇半导体设备有限公司

13E08

二谐波晶圆检测设备 ASPIRER3000



高精度二谐波晶圆检测设备，采用国内首创的二谐波晶圆检测技术，通过激发、采集晶圆产生的二谐波信号检测其电学与晶格特性，实现对晶圆电学性能、薄膜质量、表面质量以及材料质量等方面的全面检测，实现高精度、高效率的晶圆检测，支持检测多种材料，实现在线监测，适用于多种器件、工艺及制程。

上海芯上微装科技股份有限公司

16F01

晶圆级先进封装光刻机



设备主要应用于人工智能及先进智能终端等各种高端芯片封装领域，可满足扇入晶圆级封装（WLCSPP）、扇出晶圆级封装（FOWLP）和2.5D/3D等各种晶圆级先进封装的光刻工艺需求。该设备具有高分辨率、大曝光视场、工艺适应性强等优势。



半导体设备

日联科技

16E20

LX9200 3D在线自动检测设备



日联科技 LX9200 3D在线X射线检测设备 专注于PCBA(SMT、DIP)、IGBT等精密元件检测覆盖IC、BGA、CHIP、PTH及特殊行业应用自研新技术，提升检测精确度、检测速度 满足多样化检测需求，性能稳定且表现出色。

苏州恩腾半导体科技有限公司

16F72

半导体槽式清洗设备



定制化机型，通过酸槽配置，进行浸泡式制程，搭配温控机制、流场循环、上下晃动、超音波震荡、混酸补酸机制、干燥机制等功能。同时具备高产出、低成本优势，可同时处理各种尺寸晶圆及基板，适用于MetalEtch、Silicon Etch、Oxide Etch、Nitride Etch、PR Strip、RCAClean、Glass Clean等工艺。

俐玛精密测量技术（苏州）有限公司

14F28

RMX 3000离线式X-RAY检测系统



平面CT检测设备 高对比度成像，良好的成像一致性；开放式射线管，自校准功能；五轴运动平台，全方位连续自由观测；可选配ACT/PCT 扫描模式。

上银科技(中国)有限公司

14E62

晶圆装卸机



HIWIN晶圆装卸机Load Port HLP系列可共享8吋与12吋产品加载载出，能直接对应8吋与12吋FOUP/FOSB，亦可选配8吋open cassette、12吋metal carrier的载具对接平台。

山善（深圳）贸易有限公司

16F49

RKU-RKU碌碌高精度高速微细加工机MEGA-VII400



采用高刚性龙门结构（立柱横梁一体铸造 + 3 点支撑床身），油雾润滑陶瓷滚珠轴承主轴配热分离系统（H.I.S）。X/Y/Z 轴配超精密滚柱导轨、大直径丝杆及 2nm 光栅尺全闭环，定位精度 $\pm 0.5\mu\text{m}$ ，加工精度 $\leq 0.005\text{mm}$ 。行程 $410 \times 330 \times 200\text{mm}$ ，标配 20 支 HSK-E25 刀库（可选 40/60支），主轴转速 $3000-40000\text{min}^{-1}$ ，进给速度 15000mm/min 。

江苏容道社半导体设备科技有限公司

14F08

RPA-600 投影式光刻机



核心性能：精密光刻能力分辨率达 $1.5\mu\text{m}$ ，焦深（DOF） $6-8\mu\text{m}$ ，套刻精度 $3\sigma \leq 0.6\mu\text{m}$ ，光强均匀性 $< 3\%$ ，数值孔径（NA）0.158，支持I-line（365nm）、H-line（405nm）、G-line（436nm）多波段曝光。兼容 5/6/7英寸掩模版与 4/5/6英寸晶圆，标准产能 100 WPH（片/小时）。紧凑设计： $< 4\text{m}^2$ 占地面积，显著降低洁净室空间成本。

三河建华高科有限责任公司

13K08

BG-1200S全自动曝光机



该设备主要用于MEMS、先进封装、三维封装、化合物半导体、功率器件和晶圆片光学系统等领域制造工艺中的自动对准 及曝光。本产品操作方便、稳定性高、重复性好，并具有较高的性价比，可广泛应用于科研和生产。

先进微电子装备（郑州）有限公司

13J43

12英寸全自动双轴晶圆划片机



ADT 8231源于8230平台，延续8230高效率、高精度、高性能、高可靠性的特征。支持基于FOUP的DBG半切，支持FOUP与Cassette自由切换，最大支持 12 英寸晶圆，支持 $300 \times 300\text{mm}$ 方形panel，可实现基于产品表面的精确切深控制。



半导体设备

上海御渡半导体科技有限公司

13B12

专业高效的NAND/NOR Flash 测试平台K8000系列



1、功能全面且灵活。可开发涵盖eFlash、NOR Flash、NAND Flash、ReRAM、MRAM、PCM等存储芯片所需的各种 Pattern算法； 2、高速、大并测能力。数据传输速率为800Mbps，整机最高9728数字通道； 3、优秀的ONES测试开发系统支持多位用户同时进行开发调试； 4、可靠性和稳定性强。液冷技术的应用有效解决设备发热问题。

深圳市微组半导体科技有限公司

13F20

倒装晶圆贴片机



贴装方式兼容FC倒装/WB正装；适用于12吋及12吋以下晶圆；搭载单点胶系统,可配置双点胶系统；高精度直线驱动贴片头,音圈电机实现精准力控；通用式工件台,适用于处理不同种类的基板；高精度搜寻芯片平台,芯片自动角度矫正系统,配备12吋晶圆自动扩膜系统；采用点胶独立控制系统,胶量控制更加精确,支持补胶功能；采用真空漏晶检测和重新拾取功能。

东方晶源微电子科技（北京）股份有

13C62

电子束缺陷检测设备EBI



电子束检测设备（Electron-Beam Inspection, 简称 EBI），通过超高速、大束流电子束成像系统采集硅片表面图像，搭配智能检测算法检测出硅片上的电性和物理缺陷，及时发现工艺缺陷问题，是芯片制造过程中良率提升的关键设备。

上海御微半导体技术有限公司

13E20

i12-F300系列 晶圆缺陷检测设备



i12-F300为御微新一代全自动晶圆缺陷检测产品，显著提升检测效率和明场、暗场灵敏度，精准识别细微缺陷。产品可满足半导体产线当前研发需求和未来的生产需求，支持多种半导体工艺制程，有效保障芯片制造良率和可靠性。

深圳市大族微电子科技有限公司

13E35

超快激光钻孔机



应用于SLP、CSP/BGA、FC-BGA等各类封装基板增层微小盲孔盲槽、核心层通孔加工；利用超快激光新技术，解决10μm-70μm微小孔加工难题；应用于mSAP工艺时前处理无需黑化/棕化，无悬铜；后处理无需电浆，品质更好，流程更省，相对于传统镭射设备，单台设备年碳减排超过200吨，更环保。

北京烁科中科信电子装备有限公司

13C18

中束流离子注入机CI P900、SiC中束 流离子注入机CI P900HT



CI P900工艺能力覆盖至28nm，可用于中低剂量掺杂和精确角度与剂量控制的工艺步骤，如阈值电压调整注入，沟道阻隔注入，晕注入、袋注入等工艺，整机完全适应大生产制造，具备自优化及自适应控制功能。CI P900HT:用于SiC电力电子器件制造，Si基器件制造。通过向晶圆选择性注入掺杂元素如Al、B、N、P等，形成p-n结或调控器件性能参数。最高加热温度≥500°C。

东莞市智赢智能装备有限公司

16E46

晶圆设备前端模块



全自动晶圆搬运系统，是针对200mm的晶圆而开发的半导体设备前置模块。内部采用多轴机器人进行传递晶片，提高效率；使用真空吸附的方式取放晶片，确保晶片的洁净度。行业应用：电镀合适设备、CMP设备、CVD设备、清洗键合设备 产品特点： 1. 使用三段关节臂机器人，空间小，搬运的范围更大 2.高效的传片效率，支持8、12寸晶圆传输 3.兼容性强，可以根据要求定制2、3、4个晶圆载台。

江苏快克芯装备科技有限公司

14E78

在线银烧结设备



公司着力于碳化硅芯片封装核心工艺——银烧结设备研发。2020年，公司与清华大学紧密合作深入探究工艺原理，成功开发出银烧结原型机。该设备入选苏锡常首台（套）重大装备名单，荣获 SEMICON 产品创新奖，并通过江苏省工信厅关键核心技术（装备）攻关项目验收



半导体材料

上海硅产业集团股份有限公司

13F116

半导体硅晶圆



公司提供的产品类型涵盖300mm抛光片及外延片、200mm及以下抛光片、外延片及SOI硅片。产品主要应用于逻辑与存储芯片、图像处理芯片、通用处理器芯片、传感器、射频芯片、模拟芯片等领域。

宁波江丰电子材料股份有限公司

13F49

超高纯Ta靶材



深度整合上下游钽材资源，构建起从高纯钽原料至成品靶材的全流程自主可控制备体系。成功攻克钽靶材内部微观织构精细调控的世界性难题，开发出适配全球多元制程不同机台的丰富产品类型。独家首创特殊结构设计，显著延长钽靶材使用寿命。

江苏南大光电材料股份有限公司

13C31

氟化氩、氟化氪光刻胶



宁波南大光电实现从“树脂、单体、光敏剂等原材料”到光刻胶成品的全链条自主研发，光刻胶主要产品类型：干式ArF光刻胶：适配90nm-55nm工艺；浸没式ArF光刻胶：适配28nm-14nm先进制程；KrF光刻胶：适配0.25um-0.12um工艺。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

13F100

铜化学机械抛光液



安集科技的铜及铜阻挡层化学机械抛光液，用于集成电路制造工艺中铜互连的平坦化，产品已在逻辑芯片、存储芯片等制程上量产使用，持续研发并验证用于下一代技术节点用的产品。

广东硕成科技股份有限公司

16E08

UV解粘膜系列



专注于PCB/IC载板孔金属电子化学品、PCB/IC载板干膜型光刻胶及半导体晶圆切割、晶圆减薄、先进封装领域的功能膜材料。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

13F88

三氟化氮

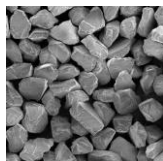


半导体制造用高纯度氟化气体 电子级三氟化氮（NF₃）是一种常温常压下呈无色透明的有毒气体，分子量为71.002，沸点为-129.06℃。该气体在微电子工业中主要用于等离子蚀刻工艺，其分解产生的活性氟离子可对硅、氮化硅等材料实现高选择性蚀刻且无残留。

河南路纳尔新材料有限公司

14E58

单晶金刚石微粉



可控的颗粒形状（磨圆、块状、不规则状）。※集中的粒度分布。※极低的杂质含量。※良好的分散性能。

上海天承科技股份有限公司

16E28

凸点电镀液SkyFab CP50



适合水平电镀和挂镀，具有优异均匀性 镀层杂质含量低，具有高延展性和抗拉强度 镀液稳定，可用于20ASD大电流密度下使用。



半导体材料

上海天承科技股份有限公司

16E28

再布线层电镀铜
SkyFabVF60

适用于水平或挂镀设备，均匀性优异可同时进行细线路电镀和盲孔填充镀液性能稳定，可CVS监控分析。

3M中国有限公司

16J70

3M晶圆临时键合和解键合解决方案



3M晶圆临时键合和解键合解决方案将世界一流的设备与3M液态紫外线固化粘合剂相结合，以帮助实现晶圆减薄。将晶圆临时键合到玻璃载片上，可提供刚性、均匀的支撑表面，从而最大限度地减少后续加工步骤中晶圆上的应力，从而减少翘曲、开裂、边缘碎裂，并提高良率。

浙江森田新材料有限公司

13G41

超净高纯电子级氢氟酸



超净高纯电子级氢氟酸：UPSSS级，产能4万吨/年；缓冲氧化蚀刻剂（BOE）：UPSSS级，产能2.7万吨/年，属定制化产品，可依据客户需求定制；高纯电子级氟化铵：UPSSS级，产能0.5万吨/年。

艾米新材(东莞)有限公司

16E128

晶圆研磨胶带UV减粘PO基膜



晶圆研磨胶带UV减粘PO基膜具有优越的缓冲性能，不析出以及优异的外观平整度，适用于晶圆以及玻璃减薄胶带。

贵研半导体材料（云南）有限公司

16F140

贵金属溅射靶材

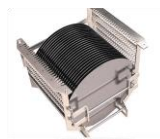


贵研半导体公司拥有高纯金属原料制备、晶粒尺寸取向控制、高焊合率绑定等集成的成套贵金属靶材制备加工技术，可提供金、金合金、铂、钯等贵金属磁控溅射靶材，规格型号包括圆形、矩形、异形及组合靶材。

新美光（苏州）半导体科技有限公司

13E10

硅片



新美光的硅片业务，涵盖了全尺寸的定制化加工工艺，主要包含硅片研磨、抛光、减薄，倒角、laser marking等工艺，公司内部可以定制生产从100um到800um不等厚度，从2寸到12寸不等直径，以及各种高中低电阻硅片，其TTV,粗糙度等指标可达到SEMI标准要求。。

安徽凯威半导体科技有限公司

14J33

高纯等静压石墨制品

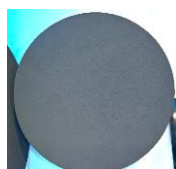


高纯等静压石墨制品，采用日本进口Ibiden材料，材料稳定性优异，加工精度高，灰分杂志含量低，广泛应用在第三代半导体6-8英寸SIC长晶等领域。

成都方大炭炭复合材料股份有限公司

14J56

多孔石墨



多孔石墨，具有开孔率高、强度高、孔径分布窄、结构均匀等特性，广泛应用于半导体、电池、催化剂、氢气储存、吸附材料等领域。



化合物半导体

北京天科合达半导体股份有限公司

14F01

8英寸导电型碳化硅衬底

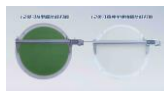


8英寸碳化硅衬底因其有效利用面积与6英寸相比提高接近90%，外延和晶圆制造成本增加不明显，且制程较6英寸更为先进等因素，可有效降低单个器件成本，在未来具有广阔的增长空间。天科合达目前已掌握高质量8英寸导电型碳化硅衬底制备的关键技术。目前取得的部分技术成果如下：低微管密度控制技术；低位错密度控制技术；电阻率均匀性控制技术。

山西烁科晶体有限公司

14F39

6/8/12寸碳化硅单晶衬底

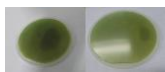


6/8/12寸高纯半绝缘碳化硅单晶衬底、6/8/12寸导电N型碳化硅单晶衬底。

河北普兴电子科技股份有限公司

14F49

碳化硅外延片

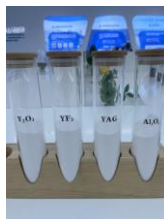


6英寸和8英寸碳化硅同质外延片产品是第三代宽禁带半导体材料，拥有禁带宽度大、载流子速度快、热导率高等优点具有重要的战略意义，其生产是当前世界各国科技竞争的焦点之一。碳化硅同质外延片是制造大功率、高压功率器件的理想材料，碳化硅功率器件比传统的硅功率器件有着更好的性能，更高的功率密度。

安徽盈锐优材科技有限公司

14D66

氧化铝

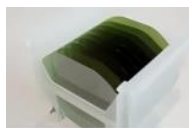


氧化铝是一种基础且极其重要的无机化工原料和功能材料。它不仅作为“工业之米”支撑着庞大的电解铝工业，其种类繁多的特种产品更是深入到现代工业的方方面面，从日常的陶瓷、玻璃、纸张，到高精尖的电子、催化、生物医药、航空航天等领域，展现出卓越的物理化学性能和广泛的应用前景。

浙江材孜科技有限公司

14E128

6英寸导电型4H-SiC衬底



6英寸导电型4H-SiC衬底 直径：(150 ± 0.2) mm 厚度：(350 ± 25) μm 导电类型：n-type 晶面取向：(0001) 向 [11-2 0] 偏4度 微管密度：≤0.1 /cm² 位错密度：TSD≤50/cm²；BPD≤500/cm² 应用方向：SiC SBD 或者 SiC MOSFET 产品类型：抛光片 (Epi-ready)

广州南砂晶圆半导体技术有限公司

14J35

6寸SiC产品



6寸导电型/半绝缘产品，可提供晶锭和衬底。

深圳市志橙半导体材料股份有限公司

13B14、14J27

氧化扩散产品

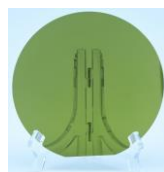


扩散氧化SiC产品及解决方案。

哈尔滨科友半导体产业装备与技术研究院有限公司

14J26

碳化硅6/8英寸衬底



碳化硅6/8英寸衬底。



半导体核心零部件

沈阳富创精密设备股份有限公司

13F72

富创精密产品图谱



机械及机电零组件代表性产品包括腔体(按使用功能分为过渡腔、传输腔和反应腔)、内衬、匀气盘、加热盘、真空阀体、托盘轴、流量计底座以及离子注入机模组、传输腔模组、过渡腔模组、刻蚀阀体模组等；气体传输体系代表性产品包括气柜模组及配套钣金组件、高洁净气体管路(EP级 管路、VCR接头、标准法兰)、阀体类Block及标准IGS Block产品。

上海杰为电子科技有限公司

13J09

抛光头、研磨头



该核心零部件采用高刚性材料与精密气压控制系统，可动态调节压力分布，适应不同材质与工艺需求，有效减少划痕、凹陷等缺陷。其模块化设计支持快速更换耗材，兼容多种抛光垫和浆料，显著提升生产效率。

上海圣永丞半导体科技有限公司

13B28

硅舟



主要应用在芯片加工的高温氧化、退火和扩散等薄膜沉积工艺中，成为新一代集成电路架构中重要的载体

安徽省众望科希盟科技有限公司

13B19

PTA全氟液体过滤器

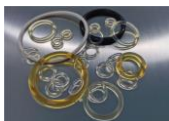


PTA全氟液体过滤器，能够广泛应用于酸、碱及其他工艺段化学料液，应用中高流量要求的场合。超大的过滤面积及高性能滤材为过滤器提供了极佳的通量和超高的截留性能。全氟的结构设计具有极佳的化学兼容性，极大程度保证产品的洁净度及使用寿命。

上海芯密科技股份有限公司

13B11

全氟密封圈



半导体级全氟橡胶密封圈。
特性：超耐高温、耐腐蚀的橡胶材料，同时具备卓越的洁净度。
用途：帮助半导体设备实现真空、密闭环境，是工艺设备的关键零部件。

星奇（上海）半导体有限公司

13G35

Surface Mount 手自一体隔膜阀



Surface Mount 手自一体隔膜阀。

上海巨良阀门集团有限公司

13G50

法兰球阀



设计特点：铸件通过德国TUV认证，硅溶胶精密铸造，外表细腻美观防火防静电设计，日本大金M111密封，出厂扭矩均衡独特阀座弹解设计，开关更平顺 下沉式压盖设计，填料部分可微调压缩量V型填料设计，保证填料密封性能 ISO5211高平台国际标准，适配国内外电/气动执行器源头厂家，具有规模化批量生产能力。

上海森桓新材料科技有限公司

13B31

Bonding Gate Seals



Bonding Gate部件主要由橡胶部件及金属部件组合而成，配合森桓自主国产材料全氟Morisz 系列橡胶，通过特殊的嵌合工艺，将橡胶部位及金属部位进行接合，在有效提高部件整体密封性的同时避免动点使用时橡胶部分可能会产生的【移位】【扭转】等风险。使部件拥有良好的耐腐蚀及密封性能。



半导体核心零部件

浙江博开机电科技有限公司

16A07、13N10

IG系列低温泵



IG系列是为高端真空装备配备的全自动智能性低温泵，具有以下特点：1) 使设备产量最优化 2) 延长正常运行时间 3) 内部加热及充氮气全自动再生系统 4) 配置可接尾气处理装置的安全阀5) 智能的“自适应”技术 - 自动低温热载荷补偿 - 变频电机系统 6) 更低的购置成本 - 每台压缩机可支持更多的泵。

季华实验室

16F100

磁控管微波电源



磁控管微波电源本产品能提供最大6kW，2.45GHz微波能量，且微波功率调节至最大输出功率的10%以下仍可保证功率波动小于2%，是一种高性能、低成本的微波发生器，通常可用至等离子刻蚀(PE)、等离子增强化学气相沉积(PECVD)、离子注入、离子辅助沉积等应用中。

深圳市高川自动化技术有限公司

16E112

网络式运动控制器



方案特点：高度集成（千兆网高速网络通讯，通讯方便，长距离分布控制等）；超强运控（复杂轨迹运动，速度前瞻，飞行加工等）；精准控制（二维坐标系补偿，平面度补偿等）；功能丰富（Windows实时插件，点胶控制工艺等）；稳定可靠（加密功能，断电加工等）。

安徽见行科技有限公司

16L55

E202 通用型电涡流传感器



E202是一款通用型单探头电涡流位移传感器，内置温度补偿模块，在探头所处的环境温度剧烈变化的情况下可大幅稳定传感器输出。探头的结构设计大大减小了塑料和粘胶的热变形对线圈平面的位置影响。探测线圈的设计使其具有更大的测量范围，直径为D的探头对应的测量范围约为0.4D，并在整个测量范围内保持高稳定性和线性度。

中村精机(无锡)有限公司

16F88

直线电机



次时代革命，经济，高速，稳定；具有高刚性，高负载，静音等特点；简洁结构设计，适应多种应用环境；重复定位精度可高达 $\pm 2\mu\text{m}$ ；支持大理石平台，平面度和直线度可达 $2.5\mu\text{m}$ 。

合肥昱驰真空技术有限公司

16J43

FF (D) 400/4500



FF系列复合分子泵采用整体型复合转子，配有涡轮抽气级和螺旋槽筒式牵引级。具有抽速大，极限真空度高、启动快、低振动、低噪声，寿命长的特点，同时可耐受较高的前级压力。可获得清洁无油的高真空环境。其中FFD型号分子泵可任意角度安装，满足用户的特殊需要。

全传科技

16F08

滚珠螺杆



MIT台湾制造、品质保证；尺寸规格齐全、满足客户需求；高研发能力、可接受客制化定制；高精度、高刚性、高稳定性、高耐用性

科哲（上海）阀门有限公司

13G06

BF200手动瓶阀



BF200/BF200Q系列电子级不锈钢手动/气动瓶阀。



半导体核心零部件

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

16F78

ALD阀门(UHP) 原子层沉积高速控制阀



高速驱动，超高循环寿命；Cv 范围为 0.27 ~ 0.62；采用耐热执行器，使用温度高达 392°F (200°C)；可选购电子或光学执行器位置传感；采用 316L VIM-VAR 不锈钢本体，适用于超高纯应用；模块化表面安装，管道对接焊接和 VC (VCR) 端口连接

捷锐企业(上海)有限公司

16G37

IGS气体元组件



IGS基座和密封垫片、IGS减压器、IGS手动膜片阀、IGS气动膜片阀、IGS单向阀、IGS膜片式计量阀；用途：半导体制程中的特种气体控制。

爱美克空气过滤器（苏州）有限公司

16B46

直流风机过滤单元



搭载直流无刷电机的智能控制风机过滤单元更节能，采用智能控制系统，远程集中控制，实现单台或群组的无级调速可搭载MEGAcel PTFE 高效过滤器，具有极低的化学气体散播性、优秀的抗酸碱腐蚀性、优质的防水性且强度大，不易破损泄漏 易于配合吊顶龙骨安装 主要应用于一级至十万级洁净室，洁净工作台和其它洁净设备。

北京机床研究所有限公司国际贸易部

16F28

日本THK产品



主要代理产品有国测时栅高精度传感器、日本THK导轨丝杠直线系列产品、日本NBK联轴器和特殊螺丝、深圳德瑞直线电机、格兰富水泵等产品。

派纳维森（苏州）电气科技有限公司

16E12

高速铜缆



应用于数据中心通讯连接线缆。

固高伺创驱动技术(深圳)有限公司

14F100

GSFD mini系列低压伺服驱动器



GSFD mini系列低压伺服驱动器是固高伺创采用创新结构设计的一款高性能紧密型低压伺服驱动器。

北京亦盛精密半导体有限公司

13E52

碳化硅接地卡环



RING,UPPER GROUND,SIC 1.8MM

苏州讯煜电子有限公司

16J15

讯煜开放易安装式无尘拖链



是一种满足无尘环境下线缆防护及运动需求的产品，洁净等级达IPA CLASS 1，易安装式优于封闭式拖链结构，外层护套采用拉链开口式结构，便于线缆的安装和更换。中间线缆由高分子柔性线卡分隔和固定，提高线缆排布的速度和美观度，同时减少线缆外护套的磨损，延长线缆的使用寿命。支持多层叠加，支持龙骨支撑，满足长行程应用场景。



会议一览表

展会同期还将举办多场半导体相关的会议及活动，集中探讨集成电路产业的创新与发展，会议及活动一览如下，以下会议均为免费活动，闭门活动为邀请制；

会议时间	会议地点	会议名称
芯片及芯片设计		
09/10 下午	16号馆馆内会议室	端侧AI芯片新架构与新应用专题研讨会
09/10 下午	14号馆二楼14A	2025年中国RSIC-V生态大会
09/11 全天	16号馆馆内会议室	第七届硬核芯生态大会暨2025汽车芯片技术创新与应用论坛
09/11 全天	14号馆二楼14C	智控未来：边缘AI与智能控制技术行业论坛
第三代半导体/功率半导体		
09/10 下午	14号馆馆内会议室	第三代半导体设备与核心零部件产业链合作发展论坛
09/11 上午	14号馆馆内会议室	第三代半导体关键材料与制备工艺协同创新论坛
09/11 下午	14号馆馆内会议室	功率半导体器件技术与应用创新发展论坛
09/11 下午	14号馆二楼14B	2025中国新型半导体材料及应用大会
半导体制造		
09/11 上午	13号馆馆内会议室	半导体分析测试应用与设备联动发展论坛
09/11 下午	13号馆馆内会议室	半导体制造核心设备与材料发展论坛
09/11 下午	14号馆二楼14A	2025年半导体装备及零部件制造前沿与展望专题会议
09/12 上午	14号馆馆内会议室	半导体装备国产化的机遇与挑战
先进封装		
09/10 下午	13号馆馆内会议室	先进封装与TGV技术创新与优化发展论坛
09/12 上午	13号馆馆内会议室	光电合封CPO及异构集成技术研讨会
同期活动		
09/11 全天	南登录大厅二楼 红树林厅B	第27届集成电路制造年会暨供应链创新发展大会 (CICD主论坛)
09/11 下午	13号馆二楼13A	中国集成电路投资联盟理事会（闭门）
09/11 下午	13号馆二楼13B	示范性微电子学院产学研融合发展联盟理事会暨研讨会（闭门）
09/11 下午	13号馆二楼13C	集成电路检测与测试创新发展论坛
09/12 上午	13号馆二楼13C	CICD-IC制造与生态发展论坛
09/12 上午	13号馆二楼13B	CICD-IC设计与制造协同论坛

*以上会议以最终实际为准。



部分议题

➤ 设备 / 零部件突破 | 分析测试

半导体分析测试应用与设备联动发展论坛

- 晶圆缺陷检测的异构并行加速方法研究与实现
- 人工智能助力半导体测试效率与精度的提升
- 探针技术在先进工艺芯片失效分析中的应用与挑战
- 半导体制造领域316L不锈钢超净表面检测策略与方案
- 半导体封装测试的新挑战与解决方案
- 光掩模缺陷检测系统

半导体制造核心设备与材料发展论坛

- 半导体制造市场趋势分析
- 精密制程的光影贴合：平行曝光中的高功率紫外光源
- 一代设备、一代工艺、一代产品
- 12英寸电镀设备（ECP）
- 激光隐形切割装备（微射流技术）
- 半导体单晶炉国产化
- 8英寸SiC减薄+背面金属化一体机
- 兆声波关键技术的国产化替代

2025年半导体装备及零部件制造前沿与展望专题会议

- 柔性电子器件电流体微纳喷印制造及屏蔽封装技术研究
- 智能制造的发展趋势与挑战
- 聚苯胺纳米纤维复合材料可控制备及其在电磁波屏蔽的应用研究
- 智能视觉助力电子元器件质量检测

[>>> 点击查看会议一览表，了解会议详情](#)

➤ 功率器件、第三代半导体方向

第三代半导体设备与核心零部件产业链合作发展论坛

- “材料-设备-工艺-应用”全面构建协同创新生态
- 半导体碳化硅（SiC）离子注入和退火工艺
- 全球碳化硅设备及市场趋势
- 精密部件材料创新与工艺优化方案
- 超高温离子注入机
- SiC晶圆切磨抛一体化装备
- 实现碳化硅衬底降本增效减排加工的颠覆性Ultra-P&P抛光技术

第三代半导体关键材料与制备工艺协同创新论坛

- 第三代半导体材料发展现状、趋势
- 第三代半导体爆发在即：SiC与GaN如何改写全球科技竞争格局？
- 大直径高质量外延技术研究进展
- 8英寸SiC晶体生长及关键技术
- 8英寸碳化硅时代已来？
- 第三代半导体材料掺杂工艺

功率半导体器件技术与应用创新发展论坛

- 功率半导体器件在新能源领域的应用
- 功率器件的设计优化与创新
- 破解AI能耗困局！GaN&SiC推动数据中心电源能效进阶
- 埋入式SiC功率模块集成封装技术
- 离子注入机石墨零部件的国产化替代与创新

2025中国新型半导体材料及应用大会

- 新型半导体材料的应用场景
- 氮化镓在工业和汽车应用的最新进展
- 六方金刚石半导体材料发展的最新突破
- GaN国产替代的进程
- 新型材料在车规级领域的应用

[>>> 点击查看会议一览表，了解会议详情](#)



部分议题

➤ 先进封装 / TGV 前沿

先进封装与 TGV 技术创新与优化发展论坛

- 实现高性能2.5D/3D集成的关键技术
- 先进封装EDA新范式：2.5D/3D时代【设计-仿真-验证】的协同创新革新
- 面向先进封装的临时键合技术的研究进展
- 基于TSV先进封装的微系统集成技术发展现状与趋势
- 面向玻璃基板的先进封装解决方案
- 芯粒（Chiplet）集成

光电合封CPO及异构集成技术研讨会

- 基于先进封装的CPO技术发展现状及趋势
- 打造新一代2.5D/3D堆叠芯片EDA平台
- 半导体先进键合集成技术
- 玻璃基板光电合封的挑战
- CPO光模块的设计与优化

➤ 芯片设计与应用方向

第七届硬核芯生态大会暨2025汽车芯片技术创新与应用论坛

- 疯狂内卷的碳化硅，如何实现破局重生？
- AI之下，存储行业的机遇与挑战
- 先进封装如何为摩尔定律续命？
- 奔向高端之路，中国半导体行业的发展与挑战
- 氮化镓功率器件在汽车领域的机遇
- AI时代，自动驾驶产业链的挑战与机遇

2025年中国RISC-V生态大会

- RISC-V与高性能计算
- RISC-V软件与生态系统
- EDA和开源IP的RISC-V芯片设计
- 汽车电子与RISC-V生态
- RISC-V前沿技术投资和人才培养

端侧AI芯片新架构与新应用专题研讨会

- 端侧 AI 芯片架构创新
- 端侧 AI 芯片的工具链与生态建设
- 端侧 AI 芯片的应用与发展（智能终端/物联网/工业/汽车等）
- 端侧AI芯片计算效能提升
- 端侧 AI 芯片产业发展现状与趋势
- 存算一体，解锁AI大模型的边缘侧潜力
- 端侧AI应用“芯”机遇，NPU加速终端算力升级
- 可穿戴设备低功耗芯片技术
- FPGA技术新应用场景

智控未来：边缘AI与智能控制技术行业论坛

- 高性能电驱系统的功率器件与控制优化
- MCU芯片如何构建电机控制系统的“国产化安全底座”
- 存储技术赋能电驱系统：数据采集与实时处理
- 高可靠连接器在高速电驱控制系统中的创新设计
- 多传感融合提升电机控制的精度与安全性

[>>> 点击查看会议一览表，了解会议详情](#)





组团参观

- 5人报名即可成团
- 专享便捷登记通道
- 团长及每位团员参观礼品
- 定制化观展资料，提高观展效率
- 展前快递入场证件、午餐券、免费深圳地铁票（电子）
- 专人专线接待，现场拍照留念
- 免费大巴接送(报名达35人，限3小时车程内)

[>>了解更多组团详情](#)

[>>申请团体报名](#)

5人成团参观

即刻组团申请

截止时间:即日起至8月20日



提前获取入场证件
及深圳电子地铁票



午餐券
(10人以上)



免费接送巴士
(35人以上)



提前获取
参观攻略



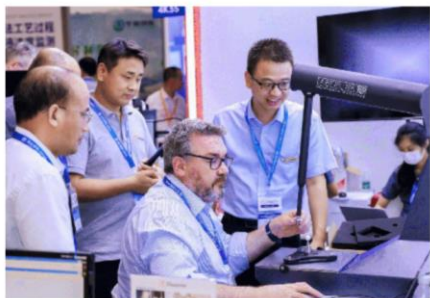
VIP商贸配对
及专人服务



一对一采购对接服务

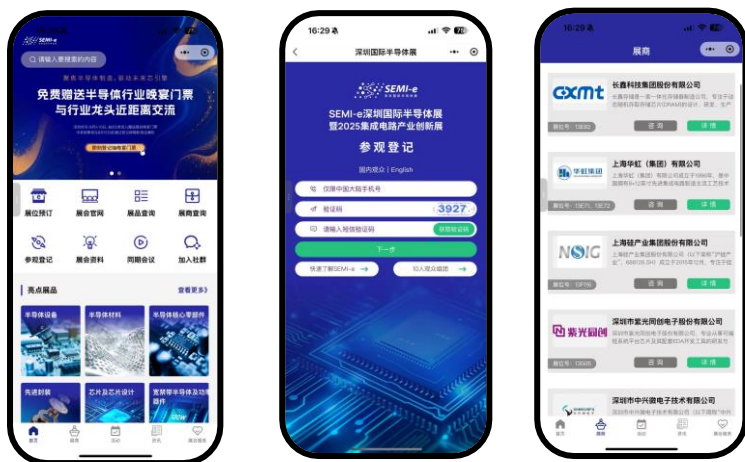
针对有供应商对接需求或采购计划的企业高层、产品研发、采购及供应链管理、生产制造、品质管理相关人员，免费提供高效的商贸对接服务【一对一采购对接服务】，帮助其快速触达供应链，提高观展效率。 [>>申请一对一采购对接服务](#)

- VIP专属通道，快速入场。
- 高端商务礼品1份。
- 享受现场VIP休息室及全天候商务茶点。
- 获取一手的展商及产品资料、采购指南等





官方小程序、企业微信



找展商 查产品 搜会议 看直播



扫码并添加至“我的小程序”
方便随时查看使用



扫码添加SEMI-e半导体展企业微信
进行行业交流群

人才招聘

为助力企业精准、高效招揽半导体领域顶尖人才，主办方特别推出线上“人才招聘专区”，为企业与精英人才搭建起一座高效对接的桥梁，关注官方小程序，实时查看企业发布的最新招聘需求。



扫码并添加至“我的小程序”
方便随时查看使用





交通指引：快速抵达深圳国际会展中心

➤ **地铁：**搭乘11号线（碧头方向）至机场北站换乘换**20号线**（会展城方向）或至南山站换乘**12号线**（海上田园方向），到达国展北站C1、C2口抵达会展中心-北登录大厅。

➤ **自驾：**导航深圳市宝安区福海街道展城路1号，深圳国际会展中心地下停车场：P2、P3、P4、P5。

➤ 高铁抵达：

①**深圳北站：**搭乘地铁5号线（赤湾方向）至灵芝站换乘12号线（海上田园方向）至国展北站C1、C2口到达北登录大厅；

②**深圳东站：**搭乘地铁14号线（岗厦北方向）至灵芝站换乘11号线（碧头方向）至机场北站换乘换20号线（会展城方向）至国展北站C1、C2口到达北登录大厅；

③**福田站：**搭乘11号线（碧头方向）至机场北站换乘换20号线（会展城方向）至国展北站C1、C2口到达北登录大厅。

➤ 深圳宝安国际机场抵达：

抵达机场后，您可选择搭乘出租车或者乘坐地铁11号线（碧头方向）至机场北站换乘换20号线（会展城方向）至国展北站C1、C2口到达北登录大厅。

➤ **广州白云国际机场抵达：**可乘坐高铁、巴士抵达深圳市内，换成公共交通至展馆。

➤ 香港出发：

①**坐船：**可从香港中港城码头乘坐客船至深圳机场码头”，再搭乘出租车到深圳国际会展中心（宝安）北登录大厅；

②**高铁：**香港九龙高铁站至福田站，搭乘11号线（碧头方向）至机场北站换乘换20号线（会展城方向）至国展北站C1、C2口到达北登录大厅。；

③**港铁：**港铁落马洲站，从福田口岸入关，港铁罗湖站从罗湖口岸入关，乘坐深圳市内交通抵达展馆；

④**香港国际机场：**可搭乘跨境巴士、轮渡（海天客运码头至深圳蛇口码头）抵达，再换成深圳市内交通抵达展馆。

详细交通信息请可进入官网查询：<https://www.semi-e.com/Traffic.html>

第26届中国国际光电博览会

覆盖光电技术全产业链的一站式综合型展会

同期
举办!

部分参展企业

- 海思、光迅、华工正源、新易盛、索尔思、昂纳、剑桥、凤凰光学、舜宇、联合光电、福光、宇瞳、辰瑞、歌尔、成都光明、联创电子、谷东科技、首镜科技、耐德佳、高德红外、睿创微纳、华感科技、海康微影、索雷博、大立科技、艾迈思欧司朗、灵敏光子、锐芯微、大族、创鑫、长光华芯、华日、公大激光、国创中心、镭昱光电、视涯、维信诺、中科院长春光机所、中科院西安光机所、中科院光电所、中科院上海光机所、中科院上海技物所等;

*以上排名不分先后

同期八大主题展



信息通信展

INFORMATION AND COMMUNICATION EXPO



精密光学展&
摄像头技术及应用展

PRECISION OPTICS EXPO & CAMERA EXPO



激光技术
及智能制造展

LASER TECHNOLOGY & INTELLIGENT MANUFACTURING EXPO



红外技术及应用展

INFRARED APPLICATIONS EXPO



智能传感展

INTELLIGENT SENSING EXPO



光电子创新展

PHOTONICS INNOVATION EXPO



AR&VR展

AR&VR EXPO



新型显示技术展

DISPLAY TECHNOLOGY EXPO

同期论坛



中国国际光电高峰论坛
CHINA INTERNATIONAL
OPTOELECTRONIC CONFERENCE

WWW.CIOE.CN



扫码报名参观



SEMI-e深圳国际半导体展
暨2025集成电路产业创新展

SEMI-e深圳国际半导体展 暨2025集成电路产业创新展

2025年9月10-12日 深圳国际会展中心(宝安)



即刻扫码登记获取参观证件

登记成功后，人人可获得：

神秘定制礼品一份(9月10-12日展会期间现场领取)

超1000页半导体行业报告合集

(登记后15个工作日内发送至登记邮箱)